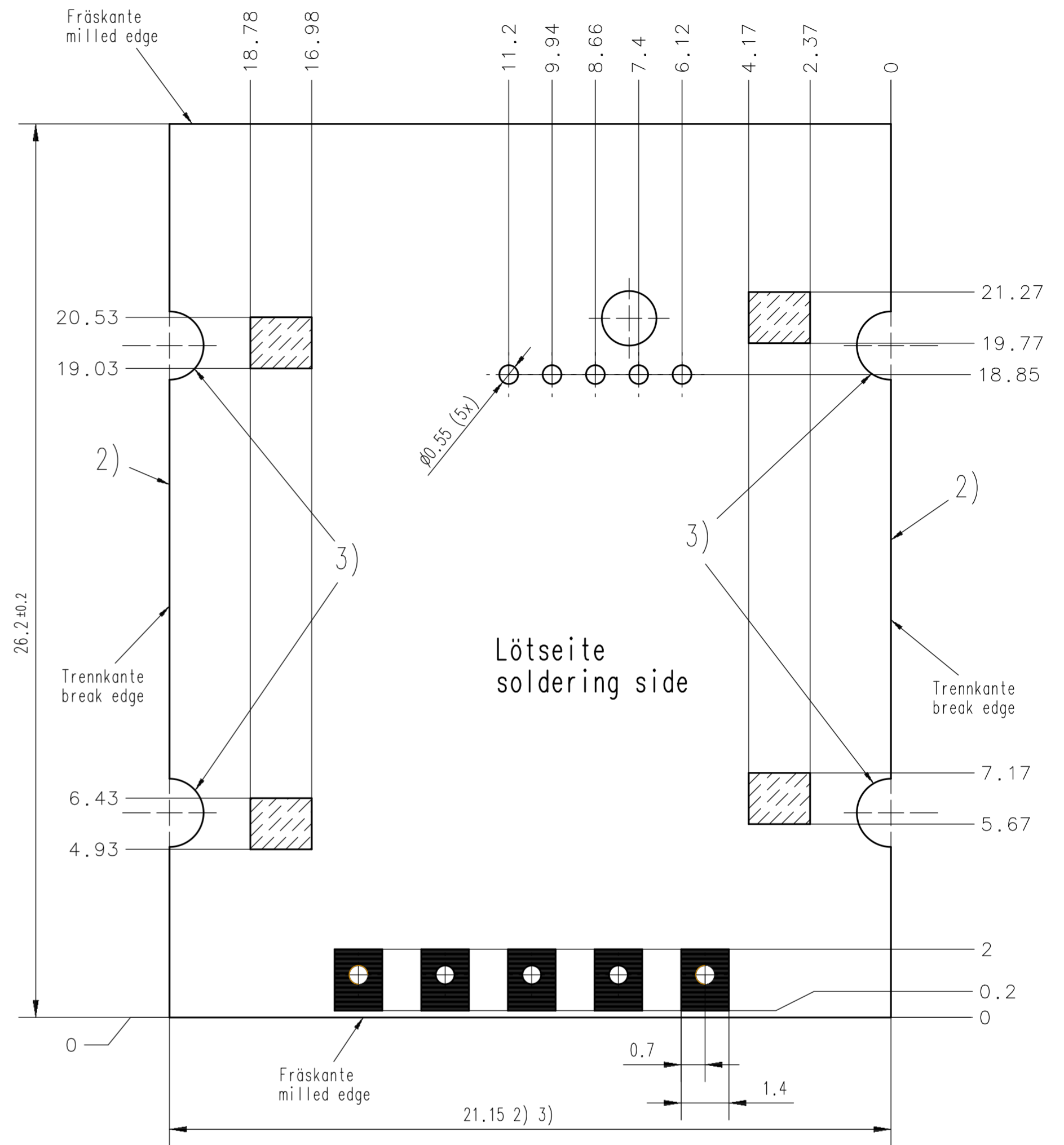
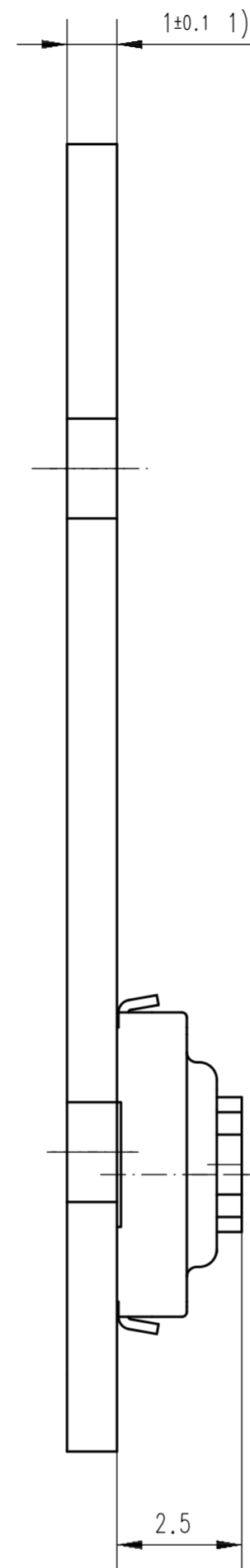
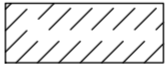
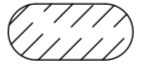

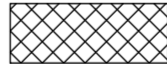
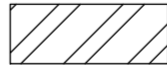


Bauteileseite
component side



Lötseite
soldering side

-   Goldkontaktfläche
contact surface gold
-  Goldfläche
surface gold
-  Sperrfläche für Bauteile (Bauteile können bis an Sperrflächen angrenzen)
blocked surface for components (components can boarder on blocked surfaces)
-  Sperrfläche für Bauteile und Gehäuseabstützung (Antennenfläche)
blocked surface for components and support for housing (antenna surface)

Versatz / displacement	Toleranz / tolerance
Fräskante zu Bohrungen milled edge to holes	± 0.2
Fräskante zu Leiterbild milled edge to conductive pattern	± 0.3
Ritzkante zu Bohrungen score edge to holes	± 0.3
Bohrungen holes	± 0.1
Bohrungen zu Leiterbild holes to conductive pattern	± 0.15

- 1) Leiterplatten Gesamtdicke mit Leiterbahnen und Lötstoplack
PC board total thickness with conductor paths and solder resist
- 2) Toleranz für Trennkante: 21.15 ± 0.3
tolerance for break edge: 21.15 ± 0.3
- 3) Toleranz für Bohrungsabstand ($\varnothing 2 \pm 0.05$): 21.15 ± 0.1
tolerance for hole pitch ($\varnothing 2 \pm 0.05$): 21.15 ± 0.1
- 4) Bauteilhöhe max. 2 mm
component height max. 2 mm

Toleranz für Kupferstrukturen ± 0.127
tolerance for copper structures ± 0.127

Alle Maße in mm
all dimensions in mm

ALS BETRIEBSGEHEIMNIS ANVERTRAUT. ALLE RECHTE VORBEHALTEN

PROPRIETARY DATA, COMPANY CONFIDENTIAL. ALL RIGHTS RESERVED

		Tit.		Massstab 8:1	
		Datum 06.11.2015		Leiterplatte PTM 535Z PC board PTM 535Z	
		Bearb. Grassl			
		Gpr. 03.08.16 SK			
		Norm.		DOLPHIN by EnOcean	
		3 Trennkante u. Pots 29.07.2016		B46-C01	
		Zur. Willigung Datum Name		Blatt 1- X Bl.	